

CEI 60191-6-2
(Première édition – 2001)

*Normalisation mécanique des dispositifs
à semiconducteurs –*

*Partie 6-2: Règles générales pour la préparation des
dessins d'encombrement des dispositifs à
semiconducteurs pour montage en surface – Guide
de conception pour les boîtiers à broches en forme
de billes et de colonnes, avec des pas de 1,50 mm,
1,27 mm et 1,00 mm*

Publication monolingue (anglais)

IEC 60191-6-2
(First edition – 2001)

**Mechanical standardization of
semiconductor devices –**

**Part 6-2: General rules for the preparation
of outline drawings of surface mounted
semiconductor device packages – Design
guide for 1,50 mm, 1,27 mm and 1,00 mm
pitch ball and column terminal packages**

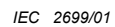
CORRIGENDUM 1

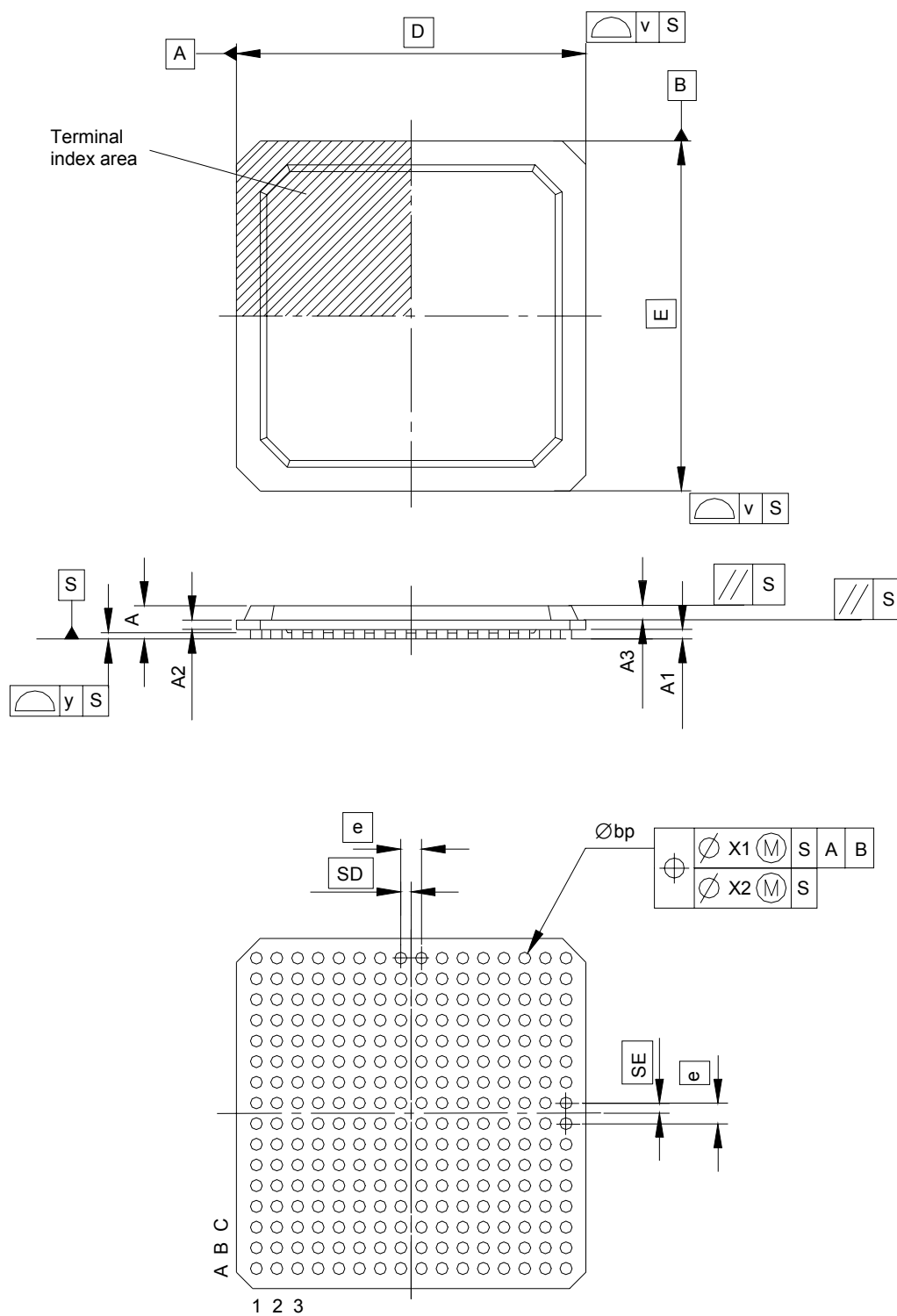
Pages 5 and 8

Clause 4 and clause 5

Reference characters and drawings

Replace the existing two figures by the following:





Pages 6 and 7

Table 2 and table 4

Under Tolerance of solder ball centre position

Instead of: x and x1

read: X1 and X2

Pages 9 and 10

Tables 6 and table 8

Under Tolerance of solder column centre position

Instead of: x and x1

read: X1 and X2